(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2002 年7 月25 日 (25.07.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/057192 A1

(51) 国際特許分類⁷: C03B 33/03, 33/023, G09F 9/00, G02F 1/1333, B28D 5/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/00258

(22) 国際出願日: 2002年1月16日(16.01.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-8796

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三星ダイヤモンド工業株式会社 (MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府吹田市 南金田二丁目12番12号 Osaka (JP).

2001年1月17日(17.01.2001)

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上山 宏樹 (UEYAMA,Hiroki) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田二丁目 1 2番 1 2号 三星ダイヤモンド工業株 式会社内 Osaka (JP). 江島谷 彰 (EJIMADANI,Akira) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田二丁目 1 2番 1 2号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 山本 秀策 (YAMAMOTO,Shusaku); 〒540-6015 大阪府 大阪市 中央区城見一丁目2番27号 クリスタルタワー15階 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.

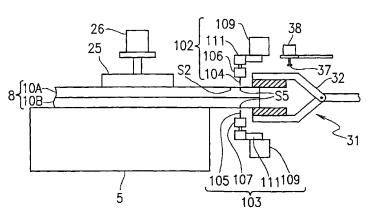
添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 補正書

/続葉有/

(54) Title: SEPARATOR AND SEPARATING SYSTEM

(54) 発明の名称: 分断装置および分断システム



(57) Abstract: A separator, characterized by comprising first and second scribe means installed on the upper and lower sides opposedly to each other to scribe the front and rear surfaces of a mother board along the scribe lines pre-set on the front and rear surfaces of the mother board formed of a brittle material and a holdingly transporting means for holdingly transporting the mother board so that the scribe lines on the mother board are positioned between the first and second scribe means.

(57) 要約:

分断装置は、脆性材料によって構成されたマザー基板の表面および裏面にそれぞれ予め設定されたスクライブラインに沿って該マザー基板の表面および裏面をそれぞれスクライブするために上下にそれぞれ対向して設けられた第1スクライブ手段および第2スクライブ手段と、該マザー基板のスクライブラインが該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間に位置するように、該マザー基板を保持して搬送する保持搬送手段とを具備することを特徴とする。

WO 02/057192 A1

. | 1881 | 1881 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 1

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明細書

分断装置および分断システム

5 技術分野

20

25

本発明は、2枚の脆性材料基板を貼り合せた貼り合せ脆性材料基板を、所定スクライブラインに沿ってスクライブすることにより分断する分断装置に関する。

背景技術

10 本明細書において、2枚の脆性材料基板を貼り合せた貼り合せ脆性材料基板には、ガラス基板を互いに貼り合せた液晶パネル、プラズマディスプレイパネル、有機ELディスプレイパネル等のフラットディスプレイパネルと、シリコン基板、サファイヤ基板等にガラス基板を貼り合せた半導体基板とが含まれる。以下、2枚の脆性材料基板を貼り合せた貼り合せ脆性材料基板として液晶パネルを例に挙げて説明する。

図45は、従来の液晶パネル分断ライン900のブロック図である。液晶パネル分断ライン900は、スクライブ装置901を備えている。図46は、スクライブ装置901は、テーブル905を備えている。テーブル905には、液晶マザーパネル908が載置されている。テーブル905は、Y1方向に移動可能に、かつ θ 1方向に回動可能に設けられている。液晶マザーパネル908は、互いに貼り合せられた2枚のガラス基板によって構成されている。

スクライブ装置 9 0 1 には、テーブル 9 0 5 に載置された液晶マザーパネル 9 0 8 を構成する 2 枚のガラス基板のうち上側のガラス基板(以下「A 面側基板」ともいう)の表面をスクライブするためのスクライブヘッド 8 1 1 が、 X 1 方向に沿って摺動自在に設けられている。 スクライブヘッド 8 1 1 には、チップホル

ダー806が取り付けられており、チップホルダー806の下端には、スクライブ予定ラインSに沿って液晶マザーパネル908をスクライブするカッターホイールチップ804が回転自在に保持されている。スクライブ装置901には、X1方向に沿ってスクライブへッド811を駆動するためのモータ812が設けられている。スクライブ装置901は、CCDカメラ929とモニタ930とを備えている。CCDカメラ929は、液晶マザーパネル908を位置決めするために液晶マザーパネルに形成されたアライメントマークを認識する。モニタ930は、CCDカメラ929によって認識されたアライメントマークを表示する。

5

10

15

20

25

スクライブ装置 901の下流側には、ブレイク装置 902が配置されている。図 47 は、ブレイク装置 902 は、テーブル 917 を備えている。テーブル 917 には、液晶マザーパネル 908 が、A面側基板が下側になるように載置されている。テーブル 917 は、Y 2 方向に移動可能に、かつ 02 方向に回動可能に設けられている。ブレイク装置 02 には、A面側基板をA面側基板に形成されたスクライブラインに沿って分断するためのブレイクバー 019 が、テーブル 017 に載置された液晶マザーパネル 017 の 01

ブレイク装置902の下流側には、スクライブ装置901Aが配置されている。 スクライブ装置901Aは、スクライブ装置901と同一の構成を有しており、 液晶マザーパネル908を構成する2枚のガラス基板のうちA面側基板以外の基 板(以下「B面側基板」ともいう)をスクライブする。

スクライブ装置901Aの下流側には、ブレイク装置902Aが配置されている。ブレイク装置902Aは、ブレイク装置902と同一の構成を有しており、 B面側基板をB面側基板に形成されたスクライブラインに沿ってブレイクする。

図48は、従来の液晶マザーパネル908の平面図である。図49は、液晶マザーパネル908から分断された液晶パネル909の斜視図である。液晶マザー

パネル908は、6分割することによって3行×2列の6個の液晶パネル909に分断される。液晶パネル909を構成する2枚のガラス基板のうちの下側のガラス基板の2辺には、端子913が形成されている。液晶マザーパネル908を構成する2枚のガラス基板の間にはシール911が設けられている。シール911と2枚のガラス基板とによって囲まれたギャップには、注入口914から液晶が注入される。

5

10

15

20

25

図50は、液晶マザーパネル908に設けられた接着用シール915を説明する平面図である。液晶マザーパネル908の周縁部および各シール911の間には、液晶マザーパネル908を分断する際に発生する切り片が飛散しないように2枚のガラス基板を接着するための接着用シール915が2枚のガラス基板の間に設けられている。

このような構成を有する液晶パネル分断ライン900の動作を説明する。図51は、従来のスクライブ装置901の動作を説明する正面図であり、図52は、従来のブレイク装置902の動作を説明する正面図である。図53は、スクライブ装置901Aの動作を説明する正面図であり、図54は、ブレイク装置902Aの動作を説明する正面図である。

図45、図46および図51を参照すると、スクライブ装置901は、図示しない給材機構によって液晶マザーパネル908がA面側基板910が上側になるようにテーブル905に載置されると、カッターホイールチップ804によってA面側基板910にスクライブラインS1を形成する。

図45、図47および図52を参照すると、スクライブ装置901によってA面側基板910をスクライブされた液晶マザーパネル908が、図示しない反転機構によって反転され、A面側基板910が下側になるようにブレイク装置902のテーブル917に載置されると、ブレイク装置902のブレークバー919は、スクライブラインS1に沿ってB面側基板912を上方から押圧することによって、A面側基板910をスクライブラインS1に沿って分断する。

図45、図46および図53を参照すると、ブレイク装置902によってA面側基板910を分断された液晶マザーパネル908が、図示しない搬送機構によって搬送され、A面側基板910が下側になるようにスクライブ装置901Aのテーブル905に載置される。ブレイク装置902によって分断された切り片916は、接着用シール915によってB面側基板912と接着されているために、液晶マザーパネル908とともにテーブル905に載置される。スクライブ装置901Aは、カッターホイールチップ804によってB面側基板912にスクライブラインS2を形成する。

5

10

15

20

25

図45、図47および図54を参照すると、スクライブ装置901Aによって B面側基板912をスクライブされた液晶マザーパネル908が、図示しない反 転機構によって反転され、B面側基板912が下側になるようにブレイク装置902Aのブレークバー919は、スクライブラインS2に沿ってA面側基板910を上方から押圧する ことによって、B面側基板912をスクライブラインS2に沿って分断する。そして、接着用シール915によって接着された切断片をまとめて除去する。

図55は、従来のさらに他のスクライブ装置950の構成図である。スクライブ装置950は、液晶マザーパネル908の両端を載置するテーブル951を備えている。テーブル951には、液晶マザーパネル908を固定する固定体952が取り付けられている。スクライブ装置950は、液晶マザーパネル908を上下から挟むように設けられた一対のカッターヘッド953および954を備えている。

このような構成のスクライブ装置 9 5 0 においては、液晶マザーパネル 9 0 8 が固定体 9 5 2 によってテーブル 9 5 1 に固定されると、一対のカッターヘッド 9 5 3 および 9 5 4 は、液晶マザーパネル 9 0 8 の表面および裏面を同時にそれ ぞれスクライブする。

しかしながら、図45~図54を参照して前述した液晶パネル分断ライン90

0では、液晶マザーパネル908を片面ごとにスクライブおよびブレイクしなければならないために、加工時間が長くなり、装置の設置面積も増大するという問題がある。

また、スクライブをした後、液晶マザーパネル908を反転させる必要があるので、液晶マザーパネル908の位置合わせが再度必要になるという問題がある。

さらに、ブレイク装置902によってA面側基板910を分断した際に発生する切り片916が取り残されたり、搬送の途中で落下してラインのトラブルを引き起こすことがないように、2枚のガラス基板を接着するための接着用シール915を2枚のガラス基板の間に設けなければならない。このため、液晶マザーパネル908自体を作製するために余分な工数が要求され、また、シール材の使用量が増大するために、液晶マザーパネル908のコストが高くなるという問題がある。

図55を参照して前述したスクライブ装置950では、スクライブ装置950によってスクライブされた液晶マザーパネル908を分断するためのブレイク装置が別途必要であり、さらに、スクライブ装置950によってスクライブされた液晶マザーパネル908を反転させてブレイク装置に供給する反転装置が別途必要であるという問題がある。

本発明の目的は、マザーパネルを分断するための加工時間を短縮することができる分断装置および分断ラインを提供することにある。

20 本発明の他の目的は、設置面積の狭い分断装置および分断ラインを提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、接着用シールを設けていないマザーパネルを分断することができる分断装置および分断ラインを提供することにある。

25 発明の開示

5

10

15

本発明に係る分断装置は、脆性材料によって構成されたマザー基板の表面およ

び裏面にそれぞれ予め設定されたスクライブラインに沿って該マザー基板の表面 および裏面をそれぞれスクライブするために上下にそれぞれ対向して設けられた 第1スクライブ手段および第2スクライブ手段と、該マザー基板のスクライブラ インが該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間に位置するように、

5 該マザー基板を保持して搬送する保持搬送手段とを具備することを特徴とし、そ のことにより上記目的が達成される。

前記保持搬送手段は、該マザー基板が該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間を通過することができるように該マザー基板を搬送してもよい。

前記保持搬送手段は、前記マザー基板を吸着して搬送してもよい。

10

15

25

前記保持搬送手段は、前記マザー基板の一端を把持しながら搬送してもよい。 前記マザー基板は、互いに貼り合せられた第1および第2ガラス基板によって 構成されており、前記第1スクライブ手段は、該第1ガラス基板をスクライブし、 前記第2スクライブ手段は、該第2ガラス基板をスクライブしてもよい。

前記マザー基板は、液晶マザーパネルであり、前記第1および第2ガラス基板の間には、液晶を封入するために設けられたシールのみが形成されていてもよい。前記保持搬送手段によって前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間へ移動される前記マザー基板が載置される第1テーブルをさらに具備し、該第1テーブルの側方に該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段が設けられていてもよい。

20 第1テーブルに対して、前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段を 挟んで第2テーブルが設けられており、前記マザー基板が前記保持搬送手段によって該第1および第2テーブルに跨って載置されてもよい。

前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の少なくとも一方によって 前記マザー基板から分断された切り片を除去する除去手段をさらに具備していて もよい。

前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段は、該第1スクライブ手段

および第2スクライブ手段によってスクライブラインが形成された前記マザー基板を前記スクライブラインに沿って分断するように、該マザー基板に所定の圧力を加えながら前記スクライブラインに沿って該マザー基板上を転動する第1および第2ローラをそれぞれ有していてもよい。

5 前記第1ローラと前記第2ローラとは、前記スクライブラインを中心として前 記マザー基板に曲げモーメントを作用させるように転動してもよい。

前記第1ローラは、前記スクライブラインに対して前記第2ローラの反対側を 転動してもよい。

前記マザー基板を載置するために設けられたテーブルをさらに具備しており、 該テーブルには、前記保持搬送手段によって搬送される該マザー基板を案内する ためのローラが設けられていてもよい。

10

15

20

25

前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段は、前記マザー基板をスクライブする第1および第2カッターホイールチップをそれぞれ有しており、該第1および第2カッターホイールチップの刃先は、互いに異なっていてもよい。

前記マザー基板の幅よりも広い幅を有する切り欠き部が形成されたテーブルを さらに具備しており、該切り欠き部には、前記第2スクライブ手段が、該切り欠 き部を跨ぐ該マザー基板の裏面をスクライブすることができるように配置されて おり、前記第1スクライブ手段は、該切り欠き部を跨ぐ該マザー基板の表面をス クライブすることができるように配置されていてもよい。

本発明に係る分断システムは、少なくとも1台の第1分断装置と少なくとも1台の第2分断装置とを具備する分断システムであって、該第1分断装置は、脆性材料によって構成された第1マザー基板の表面および裏面にそれぞれ予め設定された第1スクライブ予定ラインに沿って該第1マザー基板の表面および裏面をそれぞれスクライブするために上下に相互に対向して設けられた第1スクライブ手段および第2スクライブ手段と、該第1マザー基板の第1スクライブ予定ラインが該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間に位置するように、該第

1マザー基板を保持して搬送する第1保持搬送手段とを有しており、該第2分断装置は、該第1分断装置によって該第1マザー基板から分断された該第2マザー基板の表面および裏面に該第1スクライブ予定ラインと交差するようにそれぞれ予め設定された第2スクライブ予定ラインに沿って該第2マザー基板の表面および裏面をそれぞれスクライブするために上下に対向して設けられた第3スクライブ手段および第4スクライブ手段と、該第2マザー基板の第2スクライブラインが該第3スクライブ手段および第4スクライブ手段の間に位置するように、該第2マザー基板を保持して搬送する第2保持搬送手段とを有していることを特徴とし、このことにより上記目的が達成される。

10

5

図面の簡単な説明

図1は、実施の形態1に係る液晶パネル分断ラインの平面図である。

図2は、実施の形態1に係る液晶パネル分断装置を説明するための斜視図である。

15 図3は、図2に示す液晶パネル分断装置の要部を示す斜視図である。

図4は、図2に示す液晶パネル分断装置によって分断される液晶マザーパネル の平面図である。

図5は、図4に示す液晶マザーパネルの正面図である。

図6は、スクライブ後の液晶マザーパネルの正面図である。

20 図7は、液晶マザーパネルから分断された液晶パネルの正面図である。

図8~図16は、実施の形態1に係る液晶パネル分断装置の動作を説明するための正面図である。

図17は、実施の形態2に係る液晶パネル分断ラインの平面図である。

図18は、実施の形態2に係る液晶パネル分断装置の正面図である。

25 図19は、実施の形態2に係る液晶パネル分断装置に設けられたスクライブへッド部の構成図である。

図20~図35は、実施の形態2に係る液晶パネル分断装置の動作を説明する ための正面図である。

- 図36は、実施の形態2に係る他の液晶パネル分断ラインの平面図である。
- 図37は、実施の形態2に係るさらに他の液晶パネル分断ラインの平面図である。
 - 図38は、実施の形態3に係るガラススクライバーの斜視図である。
 - 図39は、実施の形態3に係るガラススクライバーにおける要部を説明する平 面図である。
- 図40は、実施の形態3に係る第1および第2スクライブ機構にそれぞれ設け 10 られた第1および第2カッターホイールチップを説明する正面図である。
 - 図41~図44は、実施の形態3に係るガラススクライバーのスクライブ動作を説明する図である。
 - 図45は、従来の液晶パネル分断ラインのブロック図である。
- 図46は、従来の液晶パネル分断ラインを構成するスクライブ装置の斜視図で 15 ある。
 - 図47は、従来の液晶パネル分断ラインを構成するブレイク装置の斜視図である。
 - 図48は、従来の液晶マザーパネルの平面図である。
 - 図49は、従来の液晶マザーパネルから分断された液晶パネルの斜視図である。
- 20 図50は、従来の液晶マザーパネルに設けられたシールを説明する平面図である。
 - 図51は、従来のスクライブ装置の動作を説明する正面図である。
 - 図52は、従来のブレイク装置の動作を説明する正面図である。
 - 図53は、従来の他のスクライブ装置の動作を説明する正面図である。
- 25 図54は、従来の他のブレイク装置の動作を説明する正面図である。
 - 図55は、従来のさらに他のスクライブ装置の構成図である。

発明を実施するための最良の形態

(実施の形態1)

5

10

15

20

25

実施の形態1に係る液晶パネル分断ラインは、液晶マザーパネルを液晶パネルに分断する。図1は、実施の形態1に係る液晶パネル分断ライン100の平面図である。液晶パネル分断ライン100は、液晶マザーパネル8をストックするローダ12を備えている。液晶パネル分断ライン100には、給材ロボット13が設けられている。給材ロボット13は、ローダ12にストックされた液晶マザーパネル8を1枚ずつ吸引して、コンベア14上に載置する。コンベア14上に載置された液晶マザーパネル8は、液晶パネル分断ライン100の前方(図1において右方向)へ搬送され、位置決めされる。

液晶パネル分断ライン100は、液晶パネル分断装置1を備えている。図2は、液晶パネル分断装置1を説明するための斜視図であり、図3は、図2に示す液晶パネル分断装置1の要部を示す斜視図である。液晶パネル分断装置1は、液晶マザーパネル8を載置するテーブル5を備えている。液晶パネル分断装置1には、吸着搬送機構2が設けられている。吸着搬送機構2は、コンベア14上に載置され位置決めされた液晶マザーパネル8を吸着して、テーブル5上に載置する。吸着搬送機構2は、矢印Y3に示す水平方向に沿って設けられたガイド27を有している。ガイド27には、水平方向に沿って摺動自在に設けられたアームが設けられており、アームの先端には、液晶マザーパネル8を吸着するために設けられた吸着パッド25と、吸着パッド25を上下方向に沿って駆動するためのシリンダ26とが設けられている。

図3を参照すると、液晶パネル分断装置1は、液晶マザーパネル8をスクライブするためのスクライブ機構4を備えている。スクライブ機構4は、テーブル5に対してコンベア14の反対側に配置されている。スクライブ機構4は、一対の支柱122および123には、吸

着搬送機構2によって搬送され、その一端がテーブル5からはみ出した液晶マザーパネル8を表面側および裏面側から挟むように設けられたガイドバー124および125がそれぞれ接続されている。

ガイドバー124には、液晶マザーパネル8の表面をスクライブするためのスクライブ部102が矢印X3によって示される方向に沿って摺動自在に設けられており、ガイドバー125には、液晶マザーパネル8の裏面をスクライブするためのスクライブ部103が、スクライブ部102と対向するように矢印X3の方向に沿って摺動自在に設けられている。支柱122には、スクライブ部102および103を矢印X3の方向に沿ってそれぞれ摺動させるためのモータ113および114が取り付けられている。

5

10

15

20

25

スクライブ部102は、矢印X3に示す方向に沿って摺動自在に設けられた移動体109を有している。移動体109の下面には、スクライブヘッド111が矢印Y3に示す方向に沿って摺動自在に設けられている。スクライブヘッド111の下面には、チップホルダ106が設けられている。チップホルダ106の下端には、カッターホイールチップ104が回転自在に設けられている。

スクライブ部103は、前述したスクライブ部102と同一の構成を有しており、スクライブ部102と対向するように設けられている。スクライブ部103は、矢印X3に示す方向に沿って摺動自在に設けられた移動体109を有している。移動体109の上面には、スクライブヘッド111が矢印Y3に示す方向に沿って摺動自在に設けられている。スクライブヘッド111の上面には、チップホルダ107が設けられている。チップホルダ107の上端には、カッターホイールチップ105が回転自在に設けられている。

液晶パネル分断装置1は、CCDカメラ29とモニタ30とを備えている。CCDカメラ29は、液晶マザーパネル8に形成されたアライメントマークを認識する。モニタ30は、CCDカメラ29によって認識されたアライメントマークを表示する。

11

スクライブヘッド111を矢印Y3方向に沿って摺動自在に構成したことにより、スクライブ部102のスクライブ位置とスクライブ部103のスクライブ位置とを互いにずらしてスクライブすることもできる。又、液晶マザーパネル8に記されたアライメントマークの中心を、CCDカメラ29によってとらえた画像を処理して求め、テーブル5にセットした液晶マザーパネル8が斜めにずれていた場合に、液晶マザーパネル8の斜めにずれた傾きと、スクライブ部102および103にそれぞれ設けられたカッターホイールチップ104および105の液晶マザーパネル8への切り込み開始位置を演算により求める。そして、スクライブ時に、液晶マザーパネル8のずれをキャンセルするように、スクライブ部102および103にそれぞれ設けられたスクライブへッド111を矢印Y3方向に沿って移動させつつスクライブする。このようなスクライブ方法を直線補間によるスクライブという。後述する実施の形態2および3においても同様に直線補間によるスクライブが実施される。

5

10

15

20

25

このような画像処理および演算は1回のスクライブ毎に実施されることが好ましいが、液晶マザーパネル8の分断精度が要求されない場合、または、吸着搬送機構2がテーブル5へ液晶マザーパネル8をセットする精度が良い場合には、最初に液晶マザーパネル8がセットされた時のみ画像処理および演算を実施すればよい。

再び図2を参照すると、液晶パネル分断装置1は、捕捉機構31を備えている。 捕捉機構31は、テーブル5の上面からはみ出した液晶マザーパネル8の一端を 掴むように把持する。捕捉機構31には、図2における矢印127に示す方向から見て略Y字形状をした捕捉器32が設けられている。捕捉器32は、シリンダ33の動作によって開閉自在に構成されており、テーブル5の上面からはみ出した液晶マザーパネル8の一端を掴むように把持する。捕捉器32には、一対のマット34が、把持した液晶マザーパネル8の両面と当接する位置にそれぞれ貼り付けられている。捕捉器32の上側には、吸引パッド37が設けられている。吸

引パッド37は、上下用シリンダ38によって上下動自在に設けられており、シリンダ33の上側に設けられたシリンダ39によって矢印Y3方向にも移動自在になっている。

捕捉機構31は、上下動自在に捕捉器32を支持する支柱35を備えている。 支柱35の上には、捕捉器32を上下動させるためのモータ36が設けられている。 支柱35は、図示しないモータによって矢印Y3に示す方向に沿って前後動 自在に設けられている。

5

10

15

20

25

再び図1を参照すると、液晶パネル分断ライン100は、コンベア15を備えている。コンベア15は、液晶パネル分断装置1によって分断された1列分の液晶マザーパネル8Aを下流の位置決め位置まで搬送し、位置決めする。コンベア15には、回転テーブル16が設けられている。回転テーブル16は、位置決め位置において位置決めされた液晶マザーパネル8Aを90度回転させる。

液晶パネル分断ライン100は、液晶パネル分断装置1Aを備えている。液晶パネル分断装置1Aは、幅方向の寸法が前述した液晶パネル分断装置1よりも狭い点を除いて液晶パネル分断装置1と同一の構成を有している。従って、液晶パネル分断装置1Aの構成の詳細な説明は省略する。液晶パネル分断装置1Aは、回転テーブル16によって90度回転した液晶マザーパネル8Aを液晶パネル9に分断する。液晶パネル分断装置1Aによって分断された液晶パネル9は、除材ロボット17によって製品ストック18に搬出される。

図4は、図2および図3に示す液晶パネル分断装置1によって分断される液晶マザーパネル8の平面図であり、図5は、図4に示す液晶マザーパネル8の正面図である。図6は、スクライブ後の液晶マザーパネル8の正面図であり、図7は、液晶マザーパネル8から2個に分断された1列分の液晶マザーパネル8Aの正面図である。液晶マザーパネル8は、6分割することによって3行×2列の6個の液晶パネル9に分断される。液晶マザーパネル8を構成する2枚のガラス基板の間には、シール11が設けられている。シール11と2枚のガラス基板とによっ

て囲まれたギャップには、注入口から液晶が注入される。

5

10

15

20

25

液晶マザーパネル8には、下側のガラス基板を分断するためのスクライブ予定ラインS3と、上側のガラス基板を分断するためのスクライブ予定ラインS4と、上側および下側のガラス基板を分断するためのスクライブ予定ラインS5とが設定されている。液晶マザーパネル8には、図50を参照して前述した液晶マザーパネル908のように接着用シール915は設けられておらず、液晶を注入するためのシール11のみが設けられている。

このような構成を有する液晶パネル分断ライン100の動作を説明する。給材 ロボット13がローダ12にストックされた液晶マザーパネル8を1枚ずつ吸引 して、コンベア14上に載置すると、コンベア14上に載置された液晶マザーパ ネル8は、液晶パネル分断ライン100の前方(図1において右方向)へ搬送さ れ、位置決めされる。

図8~図16は、実施の形態1に係る液晶パネル分断装置1の動作を説明するための正面図である。図5に示す領域61におけるスクライブ予定ラインS5およびS4をスクライブする動作を説明する。図8を参照すると、液晶パネル分断装置1に設けられた吸着搬送機構2の吸着パッド25は、コンベア14上において位置決めされた液晶マザーパネル8を吸引し、液晶マザーパネル8上に予め設定されたスクライブ予定ラインS5がスクライブ部102に設けられたカッターホイールチップ104とスクライブ部103に設けられたカッターホイールチップ105との間に位置するように、液晶マザーパネル8の一端がテーブル5からはみ出す位置へ液晶マザーパネル8を搬送する。カッターホイールチップ104および105は、ともに、スクライブ予定ラインS5上において対向している。テーブル5は、搬送された液晶マザーパネル8を吸引固定する。捕捉機構31に設けられた捕捉器32は、液晶マザーパネル8の一端を把持する。

カッターホイールチップ104および105は、スクライブ予定ラインS5に 沿って液晶マザーパネル8を構成するガラス基板10Aおよび10Bをそれぞれ

同時に前述した直線補間によってスクライブする。カッターホイールチップ104および105がガラス基板10Aおよび10Bへそれぞれ乗り上げるときのカッターホイールチップ104および105の移動速度を、スクライブ時における移動速度よりも小さくすると、乗り上げ時のショックによってガラス基板10Aおよび10Bに欠けが生じることを防止することができる。実施の形態に係るカッターホイールチップ104および105によれば、ガラス基板10Aおよび10Bの内側の表面にまで到達する深い垂直クラックを形成することができる。このようなカッターホイールチップ104および105としては、本出願人らによる日本国特許第3、074、143号において開示されているガラスカッターホイールチップを使用する。

5

10

15

20

25

図9を参照すると、カッターホイールチップ104および105によって、ガラス基板10Aおよび10Bの内側の表面にまで到達する深い垂直クラックがスクライブ予定ラインS5に沿って形成されているために、液晶マザーパネル8の一端を把持している捕捉器32をそのまま図9において右方向へ移動させると、形成したスクライブラインに沿って液晶マザーパネル8から分断された切り片63を除去することができる。

図10を参照すると、捕捉器32を開いて切り片63を廃棄する。そして、テーブル5は、液晶マザーパネル8の吸引固定を解除する。吸着パッド25は、スクライブ予定ラインS4がスクライブ部102に設けられたカッターホイールチップ104の下に移動するように、液晶マザーパネル8を吸着して搬送する。スクライブ部103は、邪魔にならないように紙面に対して垂直な方向に沿って移動させており、図10~図13においては図示しない。

図11を参照すると、捕捉器32は、液晶マザーパネル8の一端を把持する。 そして、カッターホイールチップ104は、スクライブ予定ラインS4に沿って ガラス基板10Aをスクライブする。

図12を参照すると、捕捉器32は液晶マザーパネル8の一端を放し、図12

において右方向である後方へ後退する。捕捉機構31に設けられた吸引パッド37は、カッターホイールチップ104によってスクライブ予定ラインS2に沿って液晶マザーパネル8から分断された切り片64を吸引する。

図13を参照すると、切り片64を吸引した吸引パッド37は、上方または図13において右方向である後方へ移動する。このようにして、カッターホイールチップ104によって液晶マザーパネル8から分断された切り片64が除去される。

5

10

15

20

25

次に、図5に示す領域62におけるスクライブラインS3、S4およびS5をスクライブする動作を説明する。図14を参照すると、吸着搬送機構2の吸着パッド25は、液晶マザーパネル8上に予め設定されたスクライブ予定ラインS5がカッターホイールチップ104とカッターホイールチップ105との間に位置するように液晶マザーパネル8を搬送する。捕捉器32は、液晶マザーパネル8の一端を把持する。カッターホイールチップ104および105は、スクライブ予定ラインS5に沿って液晶マザーパネル8を構成するガラス基板10Aおよび10Bをそれぞれ同時にスクライブする。液晶マザーパネル8の一端を把持している捕捉器32をそのまま図14において右方向へ移動させると、スクライブ予定ラインS5に沿って液晶マザーパネル8から1列分の液晶マザーパネル8Aを分断することができる。捕捉器32は、分断した液晶マザーパネル8Aを図1に示すコンベア15に載置する。

図15を参照すると、吸着パッド25は、スクライブ予定ラインS3がカッターホイール105の上へ移動し、スクライブ予定ラインS4がカッターホイール104の下へ位置するように、液晶マザーパネル8を搬送する。スクライブ部102に設けられたカッターホイールチップ104は、スクライブ予定ラインS3とS4との間の水平方向に沿った距離だけ図15において右方向に向かって移動している。カッターホイールチップ104は、ガラス基板10Aをスクライブ予定ラインS4に沿ってスクライブし、カッターホイールチップ105は、ガラス

基板10Bをスクライブ予定ラインS3に沿ってスクライブする。

5

10

15

20

25

図16を参照すると、液晶マザーパネル8の一端を把持している捕捉器32をそのまま図16において右方向へ移動させると、スクライブ予定ラインS3およびS4に沿って液晶マザーパネル8から分断された切り片65を除去することができる。

再び図1を参照すると、コンベア15は、捕捉器32によって載置された液晶マザーパネル8Aを下流の位置決め位置まで搬送し、位置決めする。回転テーブル16は、位置決め位置において位置決めされた液晶マザーパネル8Aを90度回転させる。液晶パネル分断装置1Aは、前述した液晶パネル分断装置1の動作と同様の動作によって、液晶マザーパネル8Aを液晶パネル9に分断する。液晶パネル分断装置1Aによって分断された液晶パネル9は、除材ロボット17によって製品ストック18に搬出される。

なお、2枚の脆性材料基板を貼り合せた貼り合せ脆性材料基板として液晶パネルを例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、ガラス基板を互いに貼り合せたプラズマディスプレイパネル、有機ELディスプレイパネル等のフラットディスプレイパネルと、シリコン基板、サファイヤ基板等にガラス基板を貼り合せた半導体基板とに対しても本発明を適用することができる。後述する実施の形態2および3においても同様である。

また、液晶パネル分断装置 1 が液晶マザーパネル 8 から分断した液晶マザーパネル 8 A を、液晶パネル分断装置 1 A が液晶パネル 9 に分断する例を示したが、本発明はこれに限定されない。液晶パネル分断装置 1 が液晶マザーパネル 8 から分断した液晶マザーパネル 8 A は、次工程における液晶注入装置へ捕捉機構 3 1 によって搬送されてもよい。

また、液晶パネル分断装置 1 A が分断した液晶パネル 8 を製品ストックに搬出する例を示したが、液晶パネル分断装置 1 A に設けられた捕捉器 3 1 A によって次工程における検査装置、液晶注入装置等へ搬送してもよい。

さらに、スクライブ機構4がテーブル5と捕捉機構31との間に配置されている例を示したが、本発明はこれに限定されない。液晶マザーパネル8の幅よりも広い幅を有する切り欠き部をテーブル5に形成し、この切り欠き部の中に、切り欠き部を跨ぐ液晶マザーパネル8の裏面をスクライブすることができるようにスクライブ部103を配置し、切り欠き部を跨ぐ液晶マザーパネル8の表面をスクライブすることができるようにスクライブ部102を配置するようにしてもよい。以上のように実施の形態1によれば、吸着搬送機構2は、液晶マザーパネル8

のスクライブ予定ラインがスクライブ部102および103にそれぞれ設けられたカッターホイールチップ104および105の間へ位置するように、液晶マザーパネル8を保持して搬送する。カッターホイールチップ104および105は、スクライブ予定ラインがカッターホイールチップ104および105の間へ位置するように吸着搬送機構2によって搬送された液晶マザーパネル8を、スクライブ予定ラインに沿ってスクライブすることによって分断する。

このため、2枚のガラス基板によって構成される液晶マザーパネルを両面同時に分断することができるので、液晶マザーパネルを片面ごとにスクライブおよびブレイクする必要がなくなる。その結果、反転工程およびブレイク工程が不要になるので、液晶マザーパネルを分断するための加工時間を短縮することができるとともに、液晶マザーパネルを分断するための装置の設置面積を大幅に減少させることができる。

20 (実施の形態2)

5

10

15

25

実施の形態2に係る液晶パネル分断ラインは、実施の形態1と同様に液晶マザーパネルを液晶パネルに分断する。図17は、実施の形態2に係る液晶パネル分断ライン200の平面図である。実施の形態1に係る液晶パネル分断ライン1000構成要素と同一の構成要素には同一の参照符号を付している。これらの構成要素の詳細な説明は省略する。

液晶パネル分断ライン200は、液晶マザーパネル8をストックするローダ1

2を備えている。液晶パネル分断ライン200には、給材ロボット13が設けられている。給材ロボット13は、ローダ12にストックされた液晶マザーパネル8を1枚ずつ吸引して、位置決めテーブル19上に載置する。

液晶パネル分断ライン200は、液晶パネル分断装置1Bを備えている。図18は、液晶パネル分断装置1Bの正面図である。図17および図18を参照すると、液晶パネル分断装置1Bは、液晶マザーパネル8を載置するために設けられた上流テーブル5Bおよび下流テーブル6Bは、矢印71に示す水平方向に沿って移動可能になっている。液晶パネル分断装置1Bには、吸着搬送機構2Bが設けられている。吸着搬送機構2Bは、位置決めテーブル19上に載置された液晶マザーパネル8を吸着して、上流テーブル5B上に載置する。

5

10

15

20

25

液晶パネル分断装置1Bは、液晶マザーパネル8をスクライブするためのスクライブ機構4Bを備えている。スクライブ機構4Bは、上流テーブル5Bおよび下流テーブル6Bの間に配置されている。スクライブ機構4Bは、図示しない一対の支柱を有しており、一対の支柱には、上流テーブル5Bおよび下流テーブル6Bの上方において、吸着搬送機構2Bによって搬送された液晶マザーパネル8を跨ぐように設けられたガイドバー40が接続されている。ガイドバー40の下面には、一対のレール41が形成されている。ガイドバー40には、液晶マザーパネル8を構成する2枚のガラス基板のうち上側のガラス基板をスクライブするために設けられたスクライブ部42がレール41に沿って摺動自在に設けられている。

スクライブ部42は、レール41に沿って摺動自在に設けられた移動体44を有している。移動体44の下面には、矢印71の方向に沿ってレールが設けられており、移動体47がモータM1によって矢印71の方向に移動可能に設けられている。移動体47には、台座48が固定されており、台座48には、モータM2とボールネジによって上下方向に移動可能に設けられたホルダ支持体50とが

取り付けられている。ホルダ支持体50の下端には、カッターホイールチップ51を回転自在に支持するスクライブヘッド52が設けられている。

図19は、図18における矢印Jの方向から見たスクライブヘッド52およびその周辺の機構の構成図である。ホルダ支持体50には、シリンダ53が固定され、ローラ取り付け金具54を上下動可能としている。ローラ取り付け金具54の下端には、ローラRが回転自在に取り付けられている。ローラRは、カッターホイールチップ51と一列に整列するように配置されている。ローラRとカッターホイールチップ51とは、モータM2によって上下方向に沿って一体となって昇降する。ローラRは、シリンダ53によって昇降可能となっている。ローラRは、テフロン、ジュラコン等のエンジニアリングプラスチック、硬質ゴム等の弾性体によって構成されている。ローラRの直径は、5mm以上15mm以下、厚みは、2mm以上5mm以下である。ローラRを構成するエンジニアリングプラスチック、弾性体は、静電気を防止する観点から、導電性を有していることが好ましい。

5

10

15

20

25

上流テーブル5Bの下側には、液晶マザーパネル8を構成する2枚のガラス基板のうち下側のガラス基板をスクライブするために設けられたスクライブ部43 が設けられている。スクライブ部43は、前述したスクライブ部42と同一の構成を有しており、スクライブ部42と対向するように配置されている。

下流テーブル6Bの下側には、切り片除去機構7が設けられている。切り片除去機構7は、矢印71によって示される水平方向に沿って台座56を駆動するロボットシリンダ55を備えている。ロボットシリンダ55には、ロボットシリンダ55を駆動するモータM3が取り付けられている。台座56には、シリンダ57が上下方向に沿って設けられている。シリンダ57の上端には、保持装置58が昇降自在に取り付けられている。保持装置58は、矢印59に示す方向に沿って回動自在になっている。

再び図17を参照すると、液晶パネル分断ライン200は、吸着搬送部20を

備えている。吸着搬送部20は、液晶パネル分断装置1Bによって分断された液晶マザーパネル8Aを吸着して、搬送テーブル23へ搬送する。吸着搬送部20によって液晶マザーパネル8Aが載置された搬送テーブル23は、90度回転し、液晶パネル分断装置1Cに隣接する位置へ液晶マザーパネル8Aを搬送する。

5

10

15

20

25

液晶パネル分断ライン200は、液晶パネル分断装置1Cを備えている。液晶パネル分断装置1Cは、幅方向の寸法が前述した液晶パネル分断装置1Bよりも狭い点を除いて液晶パネル分断装置1Bと同一の構成を有している。従って、液晶パネル分断装置1Cの構成の詳細な説明は省略する。液晶パネル分断装置1Cは、搬送テーブル23によって搬送された液晶マザーパネル8Aを液晶パネル9に分断する。液晶パネル分断装置1Cによって分断された液晶パネル9は、除材ロボット17によって製品ストック18に搬出される。

このような構成を有する液晶パネル分断ライン200の動作を説明する。給材 ロボット13は、ローダ12にストックされた液晶マザーパネル8を1枚ずつ吸 引して、位置決めテーブル19上に載置する。

図20~図35は、実施の形態2に係る液晶パネル分断装置1Bの動作を説明するための正面図である。図20を参照すると、液晶パネル分断装置1Bに設けられた吸着搬送機構2Bの吸引パッドは、位置決めテーブル19上に載置された液晶マザーパネル8を吸引し、液晶マザーパネル8上に予め設定されたスクライブ予定ラインがスクライブ部42に設けられたカッターホイールチップ51とスクライブ部43に設けられたカッターホイールチップ51との間に位置するように、液晶マザーパネル8の一端がテーブル5Bからはみ出す位置へ液晶マザーパネル8を搬送する。

スクライブ部42に設けられたホルダ支持体50は、モータM2によって駆動 されて下降する。スクライブ部42に設けられたカッターホイールチップ51は、 液晶マザーパネル8を構成する2枚のガラス基板のうちの上側のガラス基板に所 定の切り込み圧によって当接する。スクライブ部42に設けられたローラRは、

上側のガラス基板に所定の接触圧によって当接する。スクライブ部43においても同様に、ホルダ支持体50は、モータM2によって駆動されて上昇する。スクライブ部43に設けられたカッターホイールチップ51は、液晶マザーパネル8を構成する2枚のガラス基板のうちの下側のガラス基板に所定の切り込み圧によって当接する。スクライブ部43に設けられたローラRは、下側のガラス基板に所定の接触圧によって当接する。

5

10

15

20

図20における拡大図に示すように、スクライブ部42および43にそれぞれ 設けられたカッターホイールチップ51は、上下方向に沿って並ぶ。2個のカッターホイールチップ51は、スクライブ予定ラインに沿って液晶マザーパネル8を構成する上側ガラス基板および下側ガラス基板をそれぞれ同時に前述した直線 補間によってスクライブする。このスクライブ時において、スクライブ部42および43にそれぞれ設けられたローラRが液晶マザーパネル8を常に保持しているために、上下のカッターホイールチップ51による切込み圧を均等にすることができる。

図21を参照すると、スクライブを終了したスクライブ部42においては、ホルダ支持体50が所定量上昇する。このため、カッターホイールチップ51およびローラRは、上側ガラス基板から離れる。そして、台座48が図21において右方向へ所定量移動する。その後、シリンダ53がローラRを降下させる。この結果、ローラRのみが上側ガラス基板と所定圧で当接する。

スクライブを終了したスクライブ部43においては、ホルダ支持体50が所定量下降する。このため、カッターホイールチップ51およびローラRは、下側ガラス基板から離れる。そして、台座48が図21において左方向へ所定量移動する。その後、シリンダ53がローラRを上昇させる。この結果、ローラRのみが下側ガラス基板と所定圧で当接する。

25 このような状態において、スクライブを終了したスクライブ部42および43 にそれぞれ設けられたローラRが、スクライブを開始する前の元の位置へ戻る時

に、上側ガラス基板および下側ガラス基板の上をそれぞれ転動すると、スクライブラインを中心として液晶マザーパネル8に曲げモーメントが作用する。ローラ Rが、スクライブを開始する前の元の位置へ戻ると、スクライブ部42に設けられたローラRは上昇し、スクライブ部43に設けられたローラRは下降する。

なお、スクライブ部42に設けられたローラRを右方向へ移動させ、スクライブ部43に設けられたローラRを左方向へ移動させる例を示したが、逆に、スクライブ部42に設けられたローラRを左方向へ移動させ、スクライブ部43に設けられたローラRを右方向へ移動させてもよい。

5

10

実施の形態に係るカッターホイールチップ51によれば、ガラス基板の板厚の 約90%の深さを有する深い垂直クラックを形成することができる。各カッター ホイールチップ51によって、深い垂直クラックがスクライブラインに沿って形 成されているために、ローラRの転動に基づく曲げモーメントの作用によって液 晶マザーパネルをスクライブラインに沿って実質的に分断が完了する。従って、 図21に示す工程はブレイク工程となる。

15 図22を参照すると、保持装置58は、図22において左方向へ移動し、保持装置58に設けられたチャック部は、液晶マザーパネル8の切り片を把持する。 図23を参照すると、液晶マザーパネル8を載置した上流テーブル5Bは、左方 向に移動する。切り片は保持装置58に設けられたチャック部に把持されている。 このように、切片と液晶マザーパネル8とが離れる。

20 図24を参照すると、切片を把持したチャック部が設けられた保持装置58が下降する。図25を参照すると、保持装置58は図25の矢印によって示される反時計回り方向に回動し、保持装置58に設けられたチャック部が開き、チャック部に把持されていた切り片が落下し、廃棄される。図26を参照すると、保持装置58は元の位置へ戻る。

25 図27を参照すると、下流テーブル6Bが左方向へ移動する。吸着搬送機構2 Bに設けられた吸着パッドは、上流テーブル5Bに載置された液晶マザーパネル

8を吸着する。図28を参照すると、液晶マザーパネル8を吸着した吸着パッドは、液晶マザーパネル8の他のスクライブ予定ラインがスクライブ部42および43の間へ位置するように、液晶マザー基板8が上流テーブル5Bおよび下流テーブル6Bに跨って載置される位置へ液晶マザー基板8を搬送する。

図29を参照すると、図20に示した場合と同様にして、2個のカッターホイールチップ51は、他のスクライブ予定ラインに沿って液晶マザーパネル8を構成する上側ガラス基板および下側ガラス基板をそれぞれ同時に前述した直線補間によってスクライブする。

5

10

15

20

25

図30を参照すると、図21に示した場合と同様にして、スクライブを終了したスクライブ部42および43にそれぞれ設けられたローラRは、スクライブを開始する前の元の位置へ戻る時に、上側ガラス基板および下側ガラス基板の上をそれぞれ転動する。

図31を参照すると、液晶マザーパネル8から分断された液晶マザーパネル8 Aの一部を載置した下流テーブル6 Bは、右方向へ移動する。下流テーブル6 B に載置された液晶マザーパネル8 Aは、上流テーブル5 Bに載置された液晶マザーパネル8 から離れる。下流テーブル6 Bに載置された液晶マザーパネル8 Aは、吸着搬送部20によって搬送テーブル23へ搬送される。

図28~図31に示す工程を繰り返すことによって、液晶マザーパネル8から液晶マザーパネル8Aがさらに分断され、搬送テーブル23へ搬送される。

図32を参照すると、上流テーブル5Bに最後の液晶マザーパネル8が残される。図33を参照すると、吸着搬送部20は、液晶マザーパネル8の左端に設定されたさらに他のスクライブ予定ラインが、スクライブ部42に設けられたカッターホイールチップ51とスクライブ部43に設けられたカッターホイールチップ51との間に位置するように、液晶マザーパネル8の左端が下流テーブル6Bからはみ出す位置へ液晶マザーパネル8を搬送する。

そして、図20に示した場合と同様にして、2個のカッターホイールチップ5

T

5

10

15

20

25

1は、上記のスクライブ予定ラインに沿って液晶マザーパネル8を構成する上側ガラス基板および下側ガラス基板をそれぞれ同時に前述した直線補間によってスクライブする。その後、図21に示した場合と同様にして、スクライブを終了したスクライブ部42および43にそれぞれ設けられたローラRは、スクライブを開始する前の元の位置へ戻る時に上側ガラス基板および下側ガラス基板の上をそれぞれ転動する。

図34を参照すると、保持装置58が上昇する。図35を参照すると、保持装置58は、チャック部が下流テーブル6Bを向くように旋回する。そして、保持装置58に設けられたチャック部は、液晶マザーパネル8の切り片を把持する。その後、液晶マザーパネル8Aを載置した下流テーブル6Bは、右方向に移動する。切り片は保持装置58に設けられたチャック部に把持されている。このように、切片と液晶マザーパネル8Aとが離れる。その後、切片を把持したチャック部が設けられた保持装置58が下降する。そして、保持装置58は切り片を廃棄する。下流テーブル6Bに載置された液晶マザーパネル8Aは、吸着搬送部20によって搬送テーブル23へ搬送される。

再び図17を参照すると、吸着搬送部20によって液晶マザーパネル8Aが搬送テーブル23へ搬送されると、搬送テーブル23は、90度回動して、液晶パネル分断装置1Cに隣接する位置へ液晶マザーパネル8Aを搬送する。液晶パネル分断装置1Cは、前述した液晶パネル分断装置1Bの動作と同様の動作によって、液晶マザーパネル8Aを液晶パネル9に分断する。液晶パネル分断装置1Cによって分断された液晶パネル9は、除材ロボット17によって製品ストック18に搬出される。

以上のように実施の形態2によれば、吸着搬送機構2Bは、液晶マザーパネル8のスクライブ予定ラインがスクライブ部42および43にそれぞれ設けられたカッターホイールチップ51の間へ位置するように、液晶マザーパネル8を保持して搬送する。カッターホイールチップ51は、スクライブ予定ラインがカッタ

ーホイールチップ51の間へ位置するように吸着搬送機構2Bによって搬送された液晶マザーパネル8を、スクライブ予定ラインに沿ってスクライブする。

このため、2枚のガラス基板によって構成される液晶マザーパネルを両面同時に分断することができるので、液晶マザーパネルを片面ごとにスクライブおよびブレイクする必要がなくなる。その結果、液晶マザーパネルを分断するための加工時間を短縮することができるとともに、液晶マザーパネルを分断するための装置の設置面積を減少させることができる。

5

10

15

20

25

図36は、実施の形態2に係る他の液晶パネル分断ライン200Aの平面図である。前述した液晶パネル分断ライン200の構成要素と同一の構成要素には同一の参照符号を付している。これらの構成要素の詳細な説明は省略する。

液晶パネル分断ライン200Aは、液晶パネル分断装置1Bを備えている。液晶パネル分断装置1Bは、給材ロボット13によって供給された液晶マザーパネル8を液晶マザーパネル8Aに分断し、搬送ロボット23に供給する。搬送ロボット23は、液晶パネル分断装置1Bによって分断された液晶マザーパネルを2台の液晶パネル分断装置1Cに与える。各液晶パネル分断装置1Cは、搬送ロボット23から供給された液晶マザーパネル8Aを液晶パネル9にそれぞれ分断して、搬送ロボット23Aは、各液晶パネル分断装置1Cによってそれぞれ分断された液晶パネル9を2台の面取り装置67に供給する。各面取り装置67は、搬送ロボット23Aによって供給された液晶パネル9を面取りして、除材ロボット17に供給する。除材ロボット17は、各面取り装置67によって面取りされた液晶パネル9を次工程へ搬送する。

このように、液晶パネル分断装置1Cを並列に配置すると、タクトタイムが一層向上する。また、液晶パネル分断装置1Cの一方が故障した場合であっても、他方の液晶パネル分断装置1Cによって分断作業を継続することができる。

図37は、実施の形態2に係るさらに他の液晶パネル分断ライン200Bの平面図である。図36を参照して前述した液晶パネル分断ライン200Aと同一の

構成要素には同一の参照符号を付している。これらの構成要素の詳細な説明は省略する。液晶パネル分断ライン200Aと異なる点は、液晶パネル分断装置1Bも2台設けて並列に配置した点、給材力セット68、搬送ロボット23Bを設けた点である。

このように、液晶パネル分断装置1Bも並列に配置すると、タクトタイムがより一層向上する。また、液晶パネル分断装置1Bの一方が故障した場合であっても、他方の液晶パネル分断装置1Bによって分断作業を継続することができる。

(実施の形態3)

5

15

20

25

実施の形態3に係る液晶パネル分断装置は、液晶マザーパネルをスクライブす 10 る工程のタクトタイムを短縮する。

図38は、実施の形態3に係る液晶パネル分断装置1Dの斜視図であり、図39は、液晶パネル分断装置1Dにおける要部を説明する平面図である。液晶パネル分断装置1Dは、略長方体の形状をしたテーブル5Dを備えている。テーブル5Dの上面には、液晶マザーパネル8が、その一端がテーブル5Dの上面からはみ出すように載置されている。

液晶パネル分断装置1Dは、把持搬送機構3を備えている。把持搬送機構3は、テーブル5Dの上面からはみ出した液晶マザーパネル8の一端を掴むように把持し、テーブル5Dの上面において液晶マザーパネル8を搬送するように、液晶マザーパネル8をテーブル5Dの上面に沿って押す。把持搬送機構3には、図38における矢印131に示す方向から見て略Y字形状をした捕捉器117が設けられている。捕捉器117は、シリンダ116の動作によって開閉自在に構成されており、テーブル5Dの上面からはみ出した液晶マザーパネル8の一端を掴むように把持する。捕捉器117には、一対のマット118が、把持した液晶マザーパネル8の両面と当接する位置にそれぞれ貼り付けられている。把持搬送機構3は、上下動自在に捕捉器117を支持する支柱120を備えている。支柱120の上には、捕捉器117を上下動させるためのモータ119が設けられている。

支柱120は、図示しないモータによって矢印Y5に示す方向に沿って前後動自在に設けられている。

テーブル5Dは、液晶マザーパネル8を把持して液晶マザーパネル8を押す捕捉器117が進入することができるように、捕捉器117が液晶マザーパネル8を押す方向に沿って形成された捕捉器案内溝126を有している。捕捉器案内溝126の両側には、その上に液晶マザーパネル8が載置される複数のローラ115が、捕捉器117が液晶マザーパネル8を押す方向に沿ってそれぞれ設けられている。

5

10

25

テーブル5Dに対して把持搬送機構3の反対側には、液晶マザーパネル8をスクライブするためのスクライブ機構4Dが設けられている。スクライブ機構4Dは、一対の支柱122および123を有している。一対の支柱122および123には、把持搬送機構3によって搬送され、その他端がテーブル5Dからはみ出した液晶マザーパネル8を表面側および裏面側から挟むように設けられたガイドバー124および125がそれぞれ接続されている。

ガイドバー124には、液晶マザーパネル8の表面をスクライブするためのスクライブ機構102が矢印X4によって示される方向に沿って摺動自在に設けられており、ガイドバー125には、液晶マザーパネル8の裏面をスクライブするためのスクライブ部103が、スクライブ部102と対向するように矢印X4の方向に沿って摺動自在に設けられている。支柱122には、スクライブ部102 および103を矢印X4の方向に沿ってそれぞれ摺動させるためのモータ113 および114が取り付けられている。

図40は、スクライブ部102および103にそれぞれ設けられた第1および第2カッターホイールチップを説明する正面図である。図38および図40を参照すると、スクライブ部102は、矢印X4に示す方向に沿って摺動自在に設けられた移動体109を有している。移動体109の下面には、スクライブヘッド111がガイドバー124に対してテーブル5Dの反対側へ向って突出するよう

に設けられている。スクライブヘッド111の下面には、チップホルダ106が 設けられている。チップホルダ106の下端には、カッターホイールチップ10 4が設けられている。

スクライブ部103は、前述したスクライブ部102と同一の構成を有しており、スクライブ部102と対向するように設けられている。スクライブ部103は、矢印X4に示す方向に沿って摺動自在に設けられた移動体109を有している。移動体109の上面には、スクライブへッド111がガイドバー124に対してテーブル5Dの反対側へ向って突出するように設けられている。スクライブへッド111の上面には、チップホルダ107が設けられている。チップホルダ107の上端には、カッターホイールチップ105が設けられている。

5

10

15

20

25

スクライブ部102に設けられたカッターホイールチップ104は、チップホルダ106の回転中心128から矢印130に示す方向に向って偏心して取り付けられている。スクライブ部103に設けられたカッターホイールチップ105は、チップホルダ107の回転中心129から矢印130に示す方向に向って偏心して取り付けられている。

切断対象の種類に応じて、スクライブ部102に設けられたカッターホイールチップ104の刃先とスクライブ部103に設けられたカッターホイールチップ105の刃先とは、種類が異なっている。このため、切断対象である液晶マザーパネル8の種類に応じて柔軟に対応することができる。

このような構成を有する液晶パネル分断装置1Dの動作を説明する。図41ないし図44は、液晶パネル分断装置1Dのスクライブ動作を説明する図である。液晶マザーパネル8が、テーブル5Dに対してスクライブ機構4Dの反対側に、その一端がはみ出すように、図示しない吸着機構によってテーブル5Dに載置されると、図41に示すように、把持搬送機構3に設けられた捕捉部117は、テーブル5Dからはみ出した液晶マザーパネル8の一端を掴むように把持する。そして、把持搬送機構3に設けられた支柱120は、矢印Y5に示す方向に沿って

スクライブ機構4Dに向って移動し、支柱120に取り付けられた捕捉部117は、把持している液晶マザーパネル8を押す。液晶マザーパネル8は、テーブル5Dの上面に設けられた複数のローラ115の上を転がるようにしてスクライブ機構4Dに向かって搬送される。液晶マザーパネル8のスクライブ予定ラインが、スクライブ機構4Dに設けられたスクライブ部102および103のカッターホイールチップ104および105に対応する位置まで移動するように液晶マザーパネル8が搬送されると、支柱120は移動を停止する。

5

10

15

20

25

次に、スクライブ機構4Dの支柱122に設けられたモータ113は、ガイドバー124に沿ってスクライブ部102を駆動し、図42に示すように、スクライブ部102に設けられたチップホルダ106に取り付けられたカッターホイールチップ104は、液晶マザーパネル8の表面をスクライブ予定ラインに沿ってスクライブする。モータ114は、ガイドバー125に沿ってスクライブ部103を駆動し、図42に示すように、スクライブ部103に設けられたチップホルダ107に取り付けられたカッターホイールチップ105は、液晶マザーパネル8の裏面をスクライブラインに沿ってスクライブする。

その後、把持搬送機構3に設けられた支柱120は、さらに、矢印Y5に示す方向に沿ってスクライブ機構4Dに向って移動し、支柱120に取り付けられた捕捉部117は、さらに、把持している液晶マザーパネル8を押して、図43に示すように、テーブル5Dに設けられた捕捉器案内溝126へ進入する。液晶マザーパネル8は、テーブル5Dの上面に設けられた複数のローラ115の上をさらに搬送される。液晶マザーパネル8の他のスクライブ予定ラインが、スクライブ部102のカッターホイールチップ104に対応する位置まで移動するように液晶マザーパネル8が搬送されると、支柱120は、再び、移動を停止する。

そして、スクライブ機構4Dの支柱122に設けられたモータ113は、ガイドバー124に沿ってスクライブ部102を駆動し、図43に示すように、チップホルダ106に取り付けられたカッターホイールチップ104は、液晶マザー

パネル8の表面を他のスクライブ予定ラインに沿ってスクライブする。

5

10

15

20

25

その後、把持搬送機構3に設けられた支柱120は、さらに、矢印Y5に示す方向に沿ってスクライブ機構4Dに向って移動し、支柱120に取り付けられた捕捉部117は、さらに、把持している液晶マザーパネル8を押す。液晶マザーパネル8のさらに他のスクライブ予定ラインが、スクライブ部102および103のカッターホイールチップ104および105に対応する位置まで移動するように液晶マザーパネル8が搬送されると、支柱120は、再び、移動を停止する。次に、モータ113は、図42を参照して前述したように、ガイドバー124に沿ってスクライブ部102を駆動し、図44に示すように、カッターホイールチップ104は、液晶マザーパネル8の表面を上記スクライブ予定ラインに沿ってスクライブする。モータ114は、ガイドバー125に沿ってスクライブ部103を駆動し、図44に示すように、カッターホイールチップ105は、液晶マザーパネル8の裏面を上記スクライブ予定ラインに沿ってスクライブする。

以上のように実施の形態3によれば、把持搬送機構3は、液晶マザーパネル8のスクライブ予定ラインがカッターホイールチップに対応する位置まで移動するように液晶マザーパネル8を把持して搬送し、液晶マザーパネル8を把持した状態で、液晶マザーパネル8をスクライブ予定ラインに沿ってスクライブし、液晶マザーパネル8の他のスクライブ予定ラインがカッターホイールチップに対応する位置まで移動するように液晶マザーパネル8を順次搬送する。

従って、カッターホイールチップが液晶マザーパネル8をスクライブする前後において、把持搬送機構3は液晶マザーパネル8を把持し続ける。このため、カッターホイールチップが液晶マザーパネル8をスクライブする前後において、液晶マザーパネル8を放す動作と、再び液晶マザーパネル8を保持する動作が不要になる。この結果、液晶マザーパネル8をスクライブする工程のタクトタイムを短縮することができる。

産業上の利用可能性

5

以上のように本発明によれば、マザーパネルを分断するための加工時間を短縮 することができる分断装置および分断ラインを提供することができる。

また本発明によれば、設置面積の狭い分断装置および分断ラインを提供することができる。

さらに本発明によれば、接着用シールを設けていないマザーパネルを分断する ことができる分断装置および分断ラインを提供することができる。

請求の範囲

1. 脆性材料によって構成されたマザー基板の表面および裏面にそれぞれ予め設定されたスクライブラインに沿って該マザー基板の表面および裏面をそれぞれスクライブするために上下にそれぞれ対向して設けられた第1スクライブ手段および第2スクライブ手段と、

該マザー基板のスクライブラインが該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間に位置するように、該マザー基板を保持して搬送する保持搬送手段とを具備することを特徴とする分断装置。

10

5

- 2. 前記保持搬送手段は、該マザー基板が該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間を通過することができるように該マザー基板を搬送する、請求の範囲1記載の分断装置。
- 15 3. 前記保持搬送手段は、前記マザー基板を吸着して搬送する、請求の範囲1記載の分断装置。
 - 4. 前記保持搬送手段は、前記マザー基板の一端を把持しながら搬送する、請求の範囲1記載の分断装置。

20

25

5. 前記マザー基板は、互いに貼り合せられた第1および第2ガラス基板によって構成されており、

前記第1スクライブ手段は、該第1ガラス基板をスクライブし、

前記第2スクライブ手段は、該第2ガラス基板をスクライブする、請求の範囲 1記載の分断装置。

6. 前記マザー基板は、液晶マザーパネルであり、

前記第1および第2ガラス基板の間には、液晶を封入するために設けられたシールのみが形成されている、請求の範囲5記載の分断装置。

- 5 7. 前記保持搬送手段によって前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間へ移動される前記マザー基板が載置される第1テーブルをさらに具備し、 該第1テーブルの側方に該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段が設けられている、請求の範囲1記載の分断装置。
- 10 8. 第1テーブルに対して、前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段 を挟んで第2テーブルが設けられており、

前記マザー基板が前記保持搬送手段によって該第1および第2テーブルに跨って載置される、請求の範囲7記載の分断装置。

- 9. 前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の少なくとも一方によって前記マザー基板から分断された切り片を除去する除去手段をさらに具備している、請求の範囲1記載の分断装置。
- 10.前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段は、該第1スクライブ 手段および第2スクライブ手段によってスクライブラインが形成された前記マザー 一基板を前記スクライブラインに沿って分断するように、該マザー基板に所定の 圧力を加えながら前記スクライブラインに沿って該マザー基板上を転動する第1 および第2ローラをそれぞれ有している、請求の範囲1記載の分断装置。
- 25 11. 前記第1ローラと前記第2ローラとは、前記スクライブラインを中心として前記マザー基板に曲げモーメントを作用させるように転動する、請求の範囲1

- 0記載の分断装置。
- 12. 前記第1ローラは、前記スクライブラインに対して前記第2ローラの反対側を転動する、請求の範囲11記載の分断装置。

5

13. 前記マザー基板を載置するために設けられたテーブルをさらに具備しており、

該テーブルには、前記保持搬送手段によって搬送される該マザー基板を案内するためのローラが設けられている、請求の範囲1記載の分断装置。

10

14. 前記第1スクライブ手段および第2スクライブ手段は、前記マザー基板をスクライブする第1および第2カッターホイールチップをそれぞれ有しており、

該第1および第2カッターホイールチップの刃先は、互いに異なっている、請求の範囲1記載の分断装置。

15

15. 前記マザー基板の幅よりも広い幅を有する切り欠き部が形成されたテーブルをさらに具備しており、

該切り欠き部には、前記第2スクライブ手段が、該切り欠き部を跨ぐ該マザー 基板の裏面をスクライブすることができるように配置されており、

- 20 前記第1スクライブ手段は、該切り欠き部を跨ぐ該マザー基板の表面をスクライブすることができるように配置されている、請求の範囲1記載の分断装置。
 - 16. 少なくとも1台の第1分断装置と少なくとも1台の第2分断装置とを具備する分断システムであって、
- 25 該第1分断装置は、脆性材料によって構成された第1マザー基板の表面および 裏面にそれぞれ予め設定された第1スクライブ予定ラインに沿って該第1マザー

基板の表面および裏面をそれぞれスクライブするために上下に相互に対向して設けられた第1スクライブ手段および第2スクライブ手段と、

該第1マザー基板の第1スクライブ予定ラインが該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間に位置するように、該第1マザー基板を保持して搬送する第1保持搬送手段とを有しており、

5

10

該第2分断装置は、該第1分断装置によって該第1マザー基板から分断された 該第2マザー基板の表面および裏面に該第1スクライブ予定ラインと交差するよ うにそれぞれ予め設定された第2スクライブ予定ラインに沿って該第2マザー基 板の表面および裏面をそれぞれスクライブするために上下に対向して設けられた 第3スクライブ手段および第4スクライブ手段と、

該第2マザー基板の第2スクライブラインが該第3スクライブ手段および第4 スクライブ手段の間に位置するように、該第2マザー基板を保持して搬送する第 2保持搬送手段とを有していることを特徴とする分断システム。

補正書の請求の範囲

[2002年5月29日 (29.05.02) 国際事務局受理:出願当初の請求の範囲 1は補正された:他の請求の範囲は変更なし。(1頁)]

1. (補正後) 脆性材料によって構成されたマザー基板の表面および裏面にそれぞれ予め設定されたスクライブ予定ラインに沿って該マザー基板の表面および裏面をそれぞれスクライブするために上下にそれぞれ対向して設けられた第1スクライブ手段および第2スクライブ手段と、

該マザー基板のスクライブ予定ラインが該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間に位置するように、該マザー基板を保持して搬送する保持搬送手段とを具備することを特徴とする分断装置。

10

- 2. 前記保持搬送手段は、該マザー基板が該第1スクライブ手段および第2スクライブ手段の間を通過することができるように該マザー基板を搬送する、請求の範囲1記載の分断装置。
- 15 3. 前記保持搬送手段は、前記マザー基板を吸着して搬送する、請求の範囲1記載の分断装置。
 - 4. 前記保持搬送手段は、前記マザー基板の一端を把持しながら搬送する、請求の範囲1記載の分断装置。

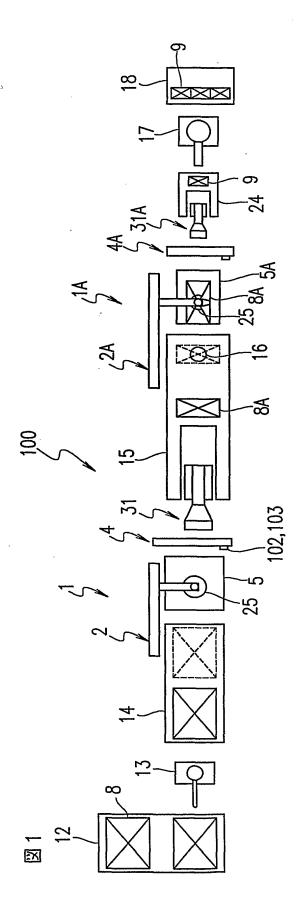
20

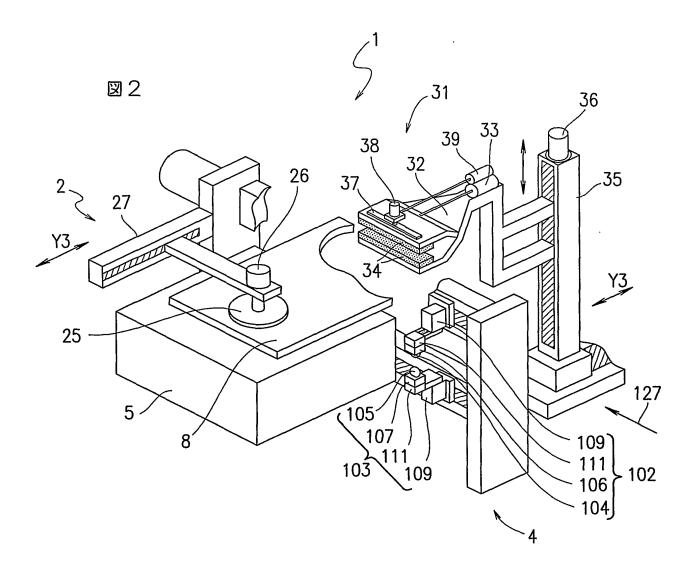
5. 前記マザー基板は、互いに貼り合せられた第1および第2ガラス基板によって構成されており、

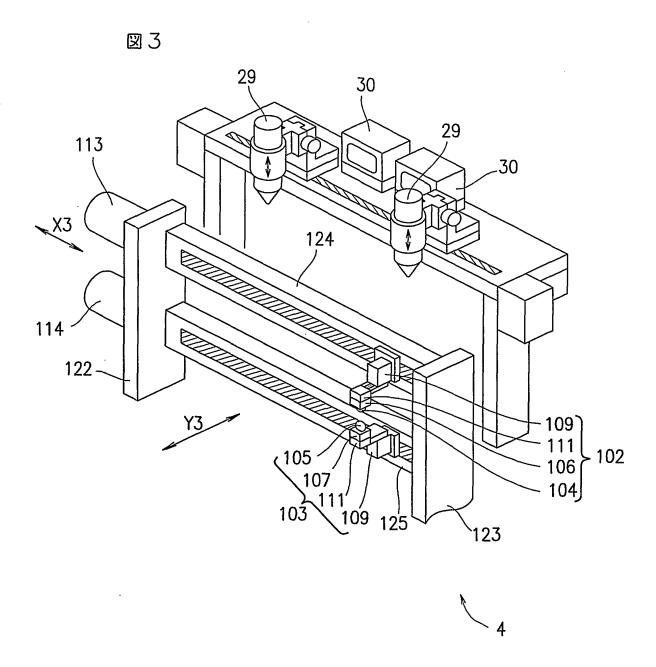
前記第1スクライブ手段は、該第1ガラス基板をスクライブし、

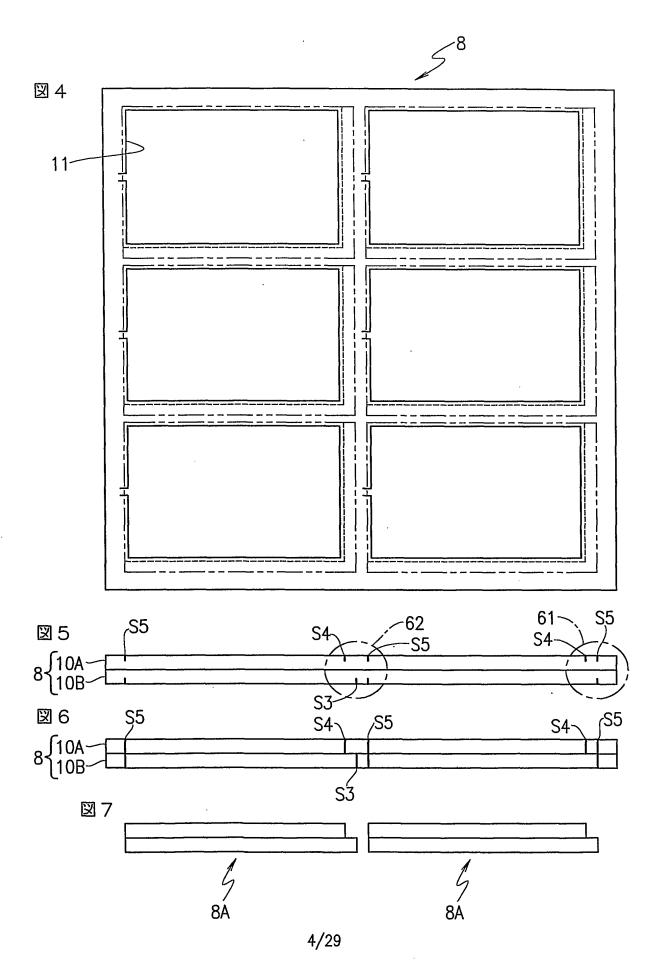
前記第2スクライブ手段は、該第2ガラス基板をスクライブする、請求の範囲

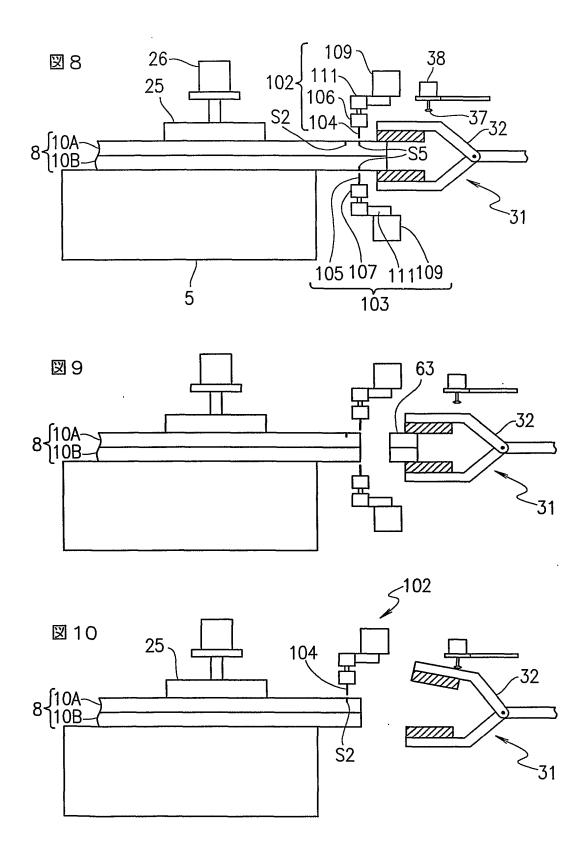
25 1記載の分断装置。

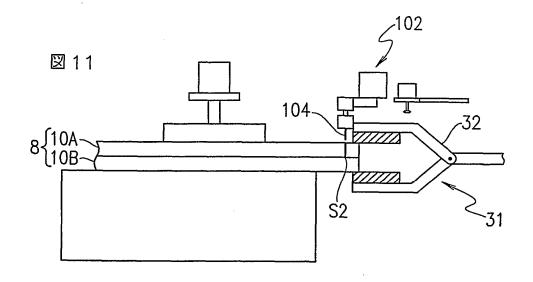


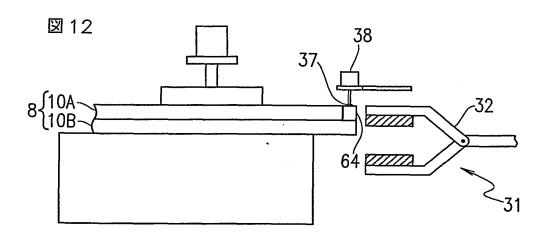


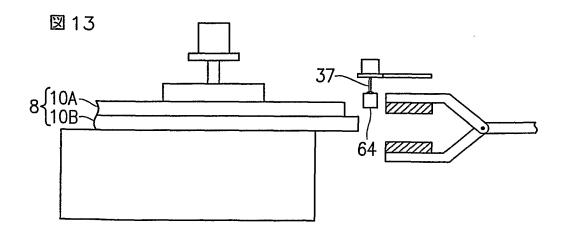


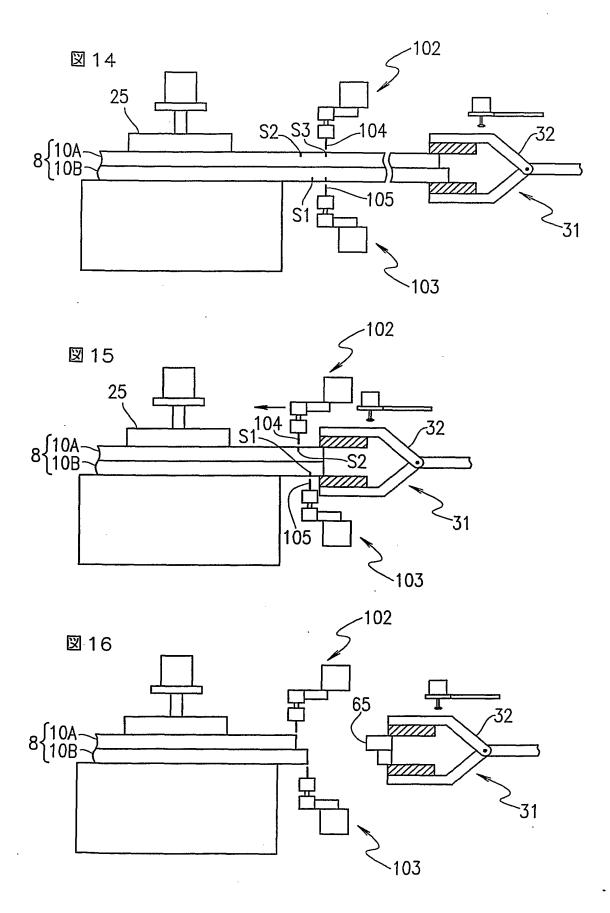


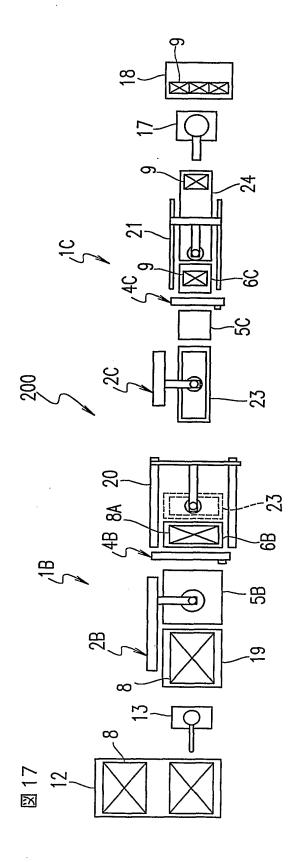


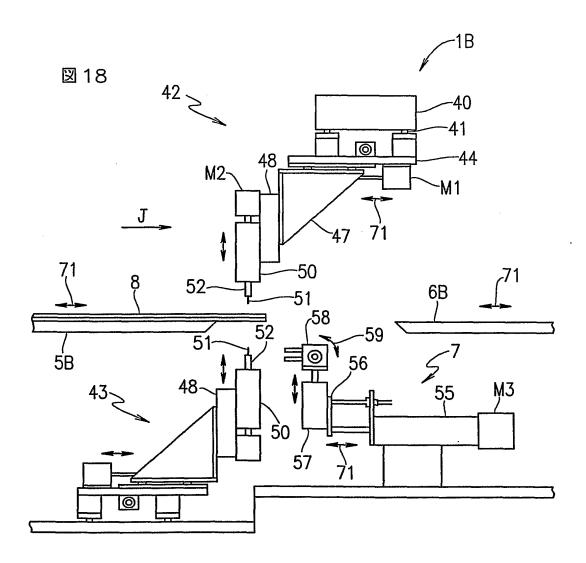


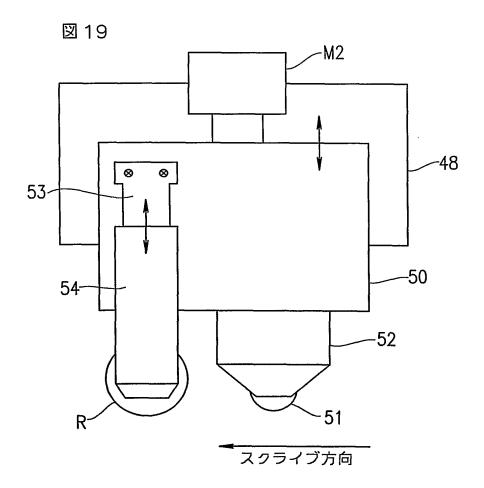


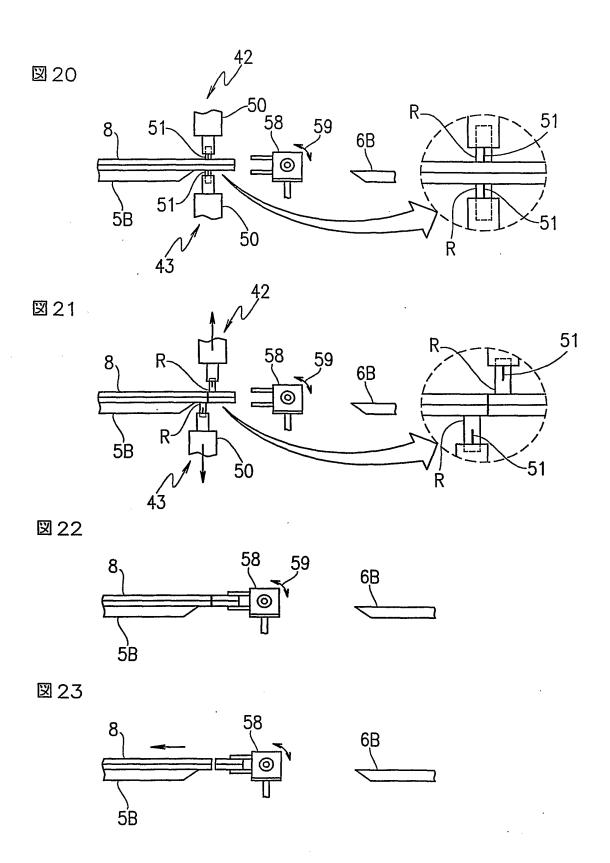


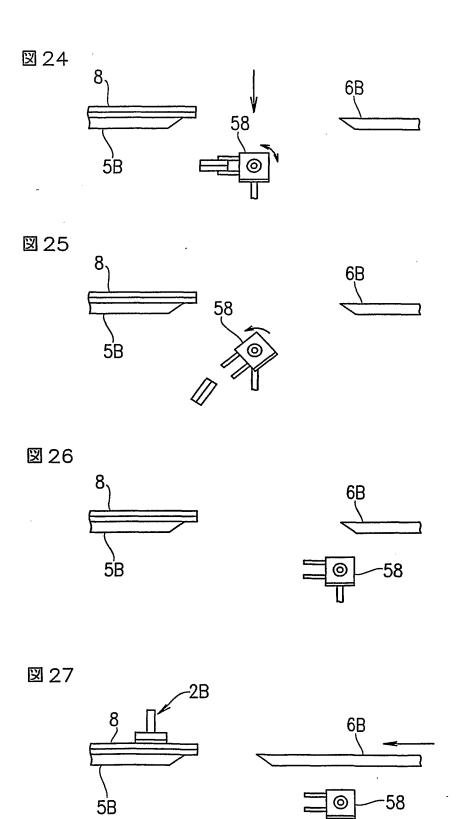


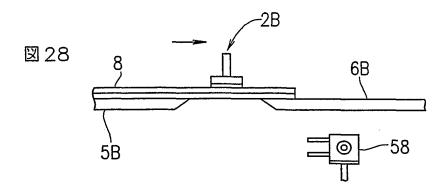


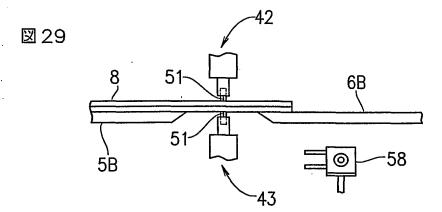












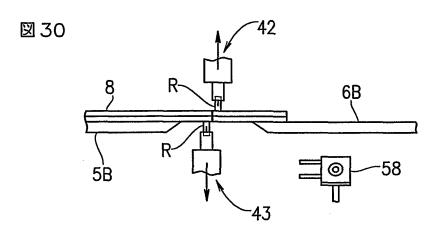
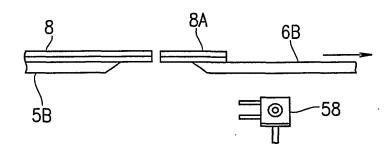
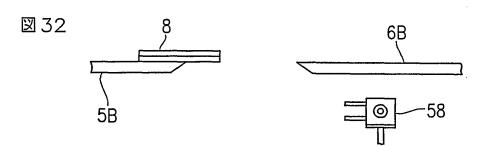
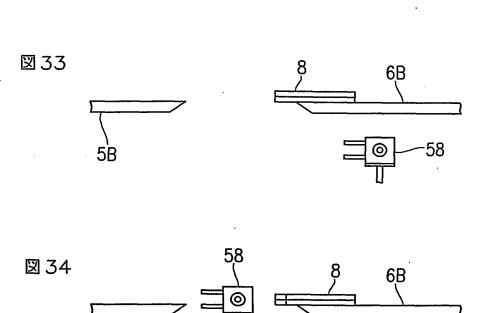
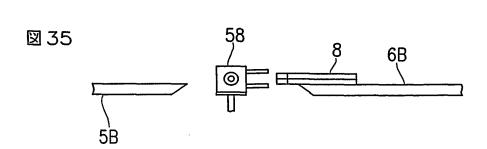


図31

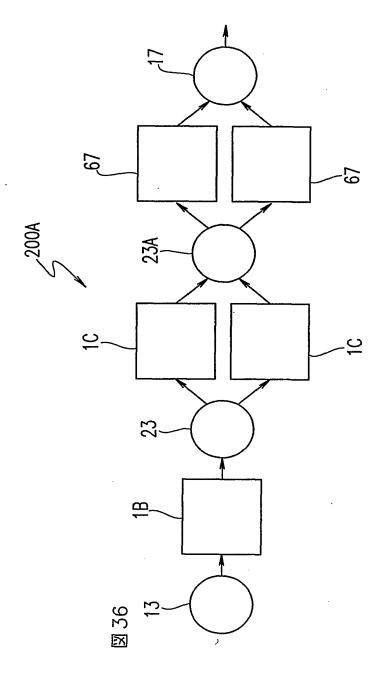


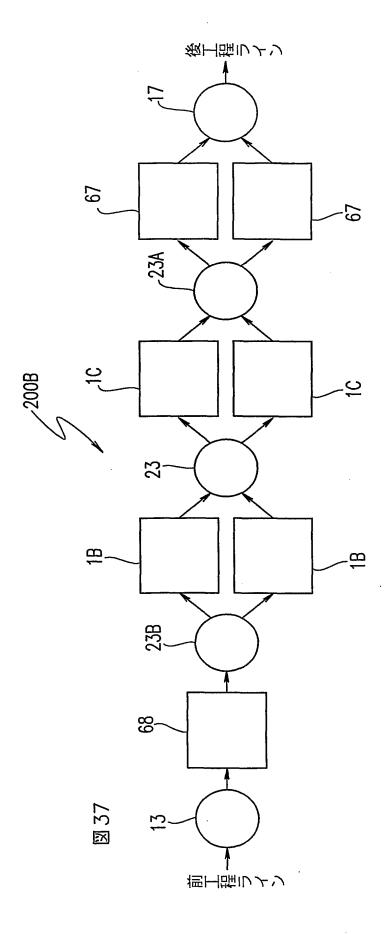


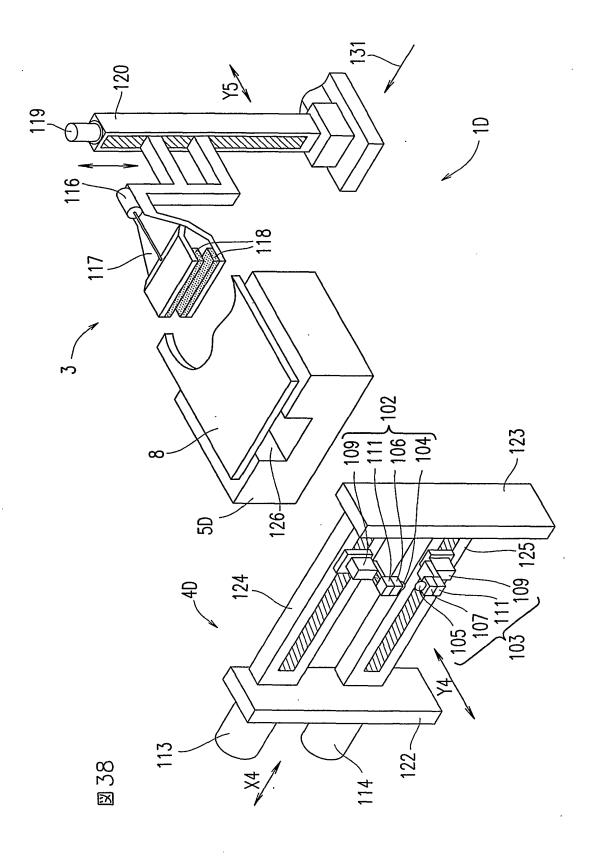


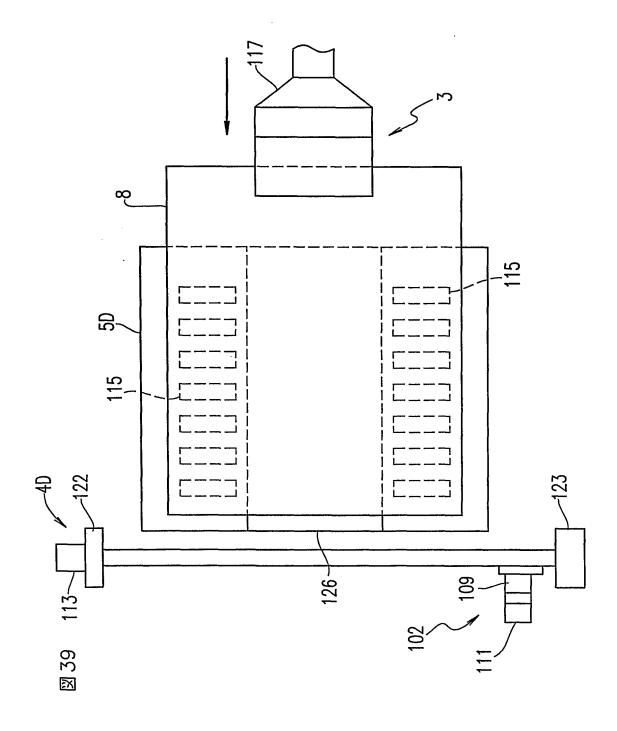


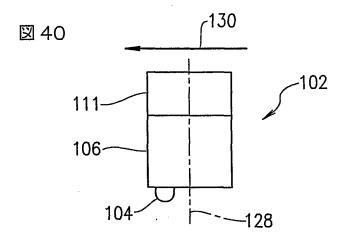
5B

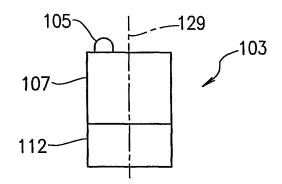


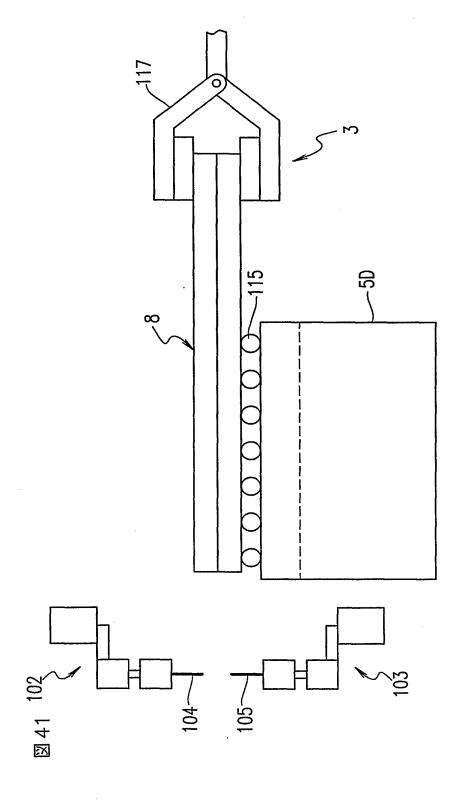


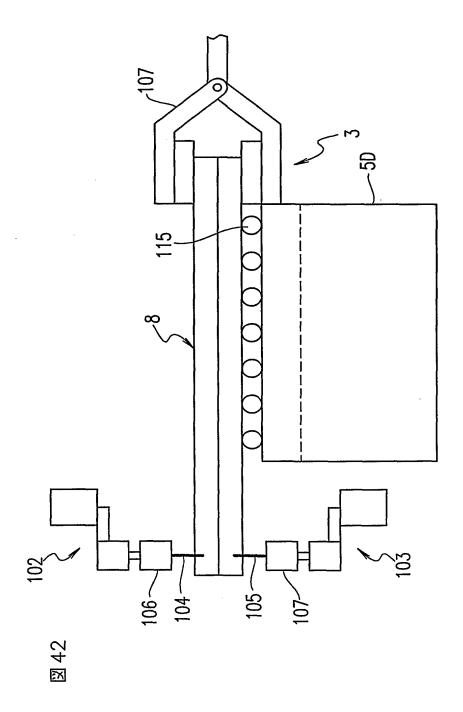


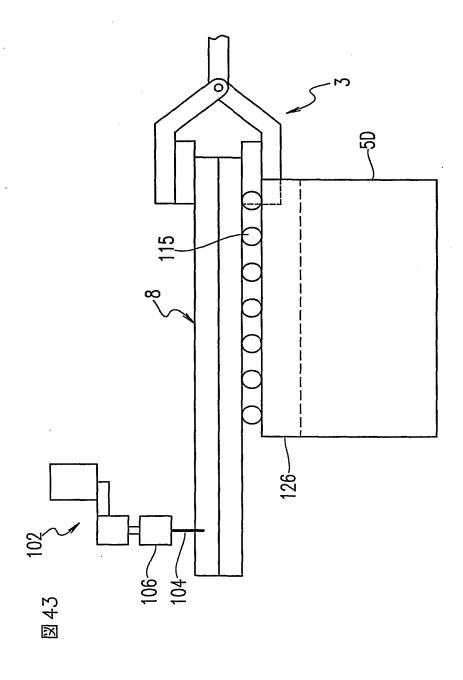


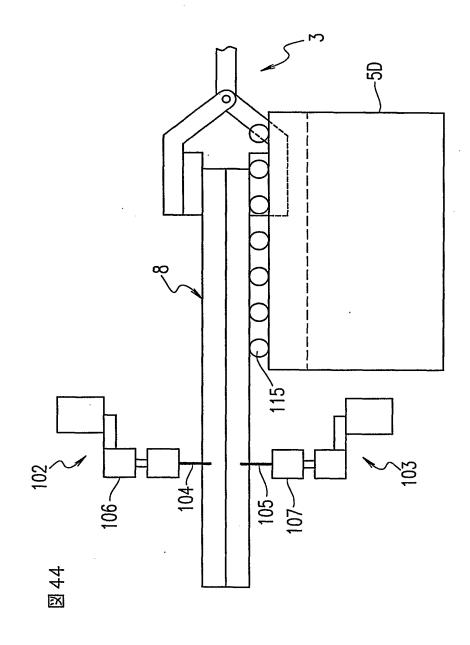


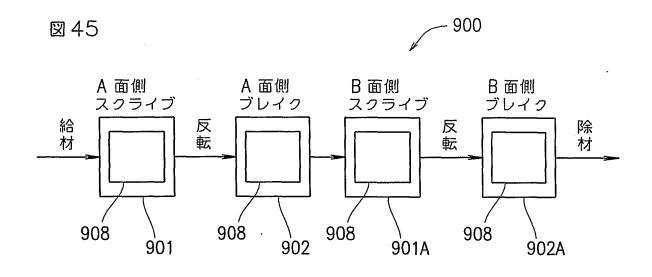


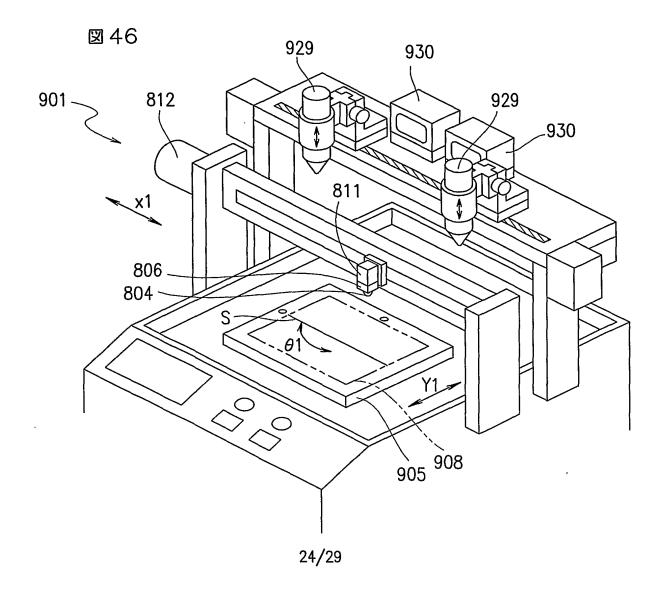


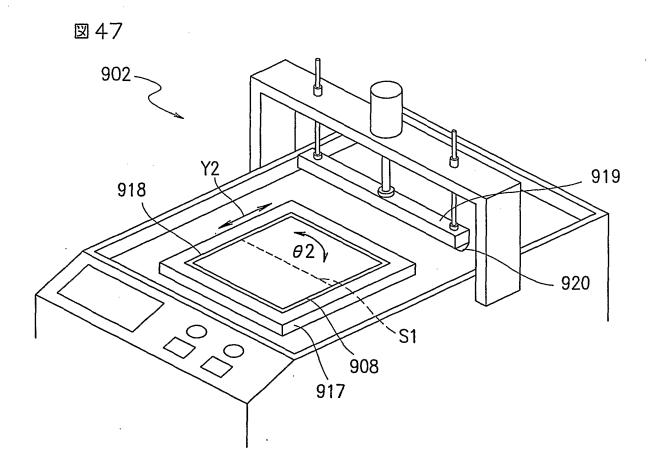


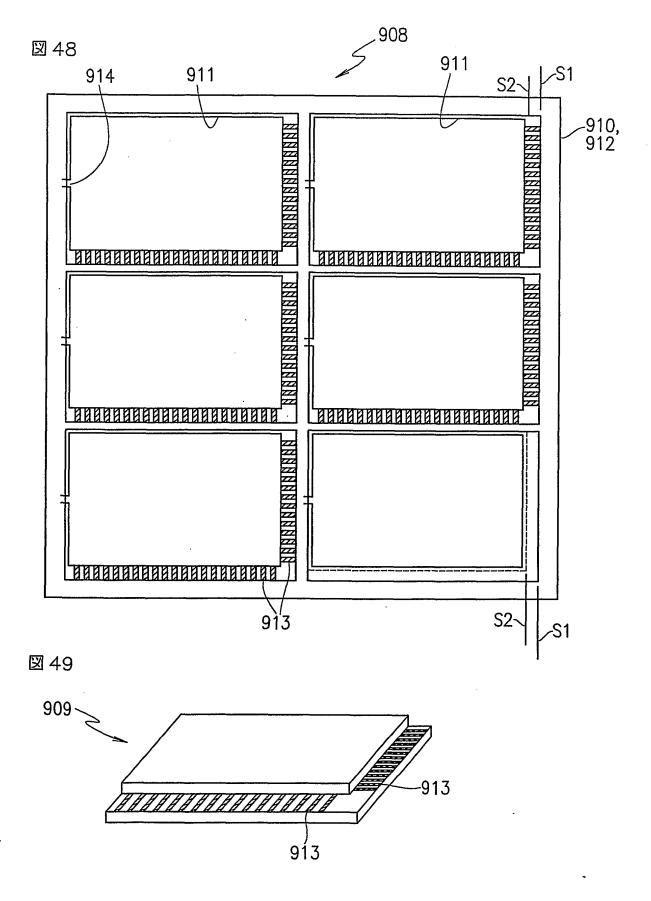


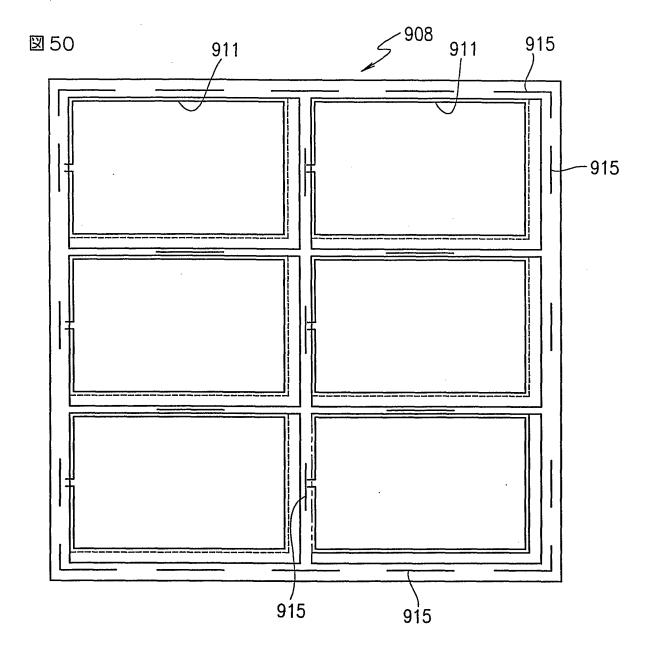


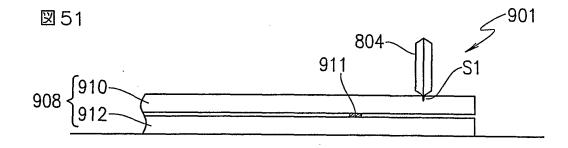


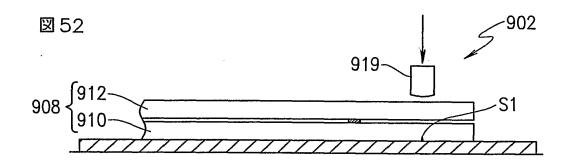


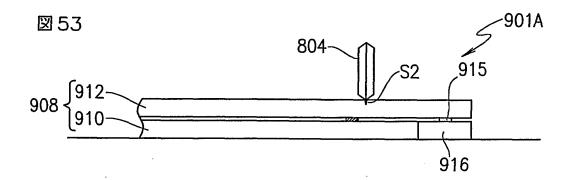


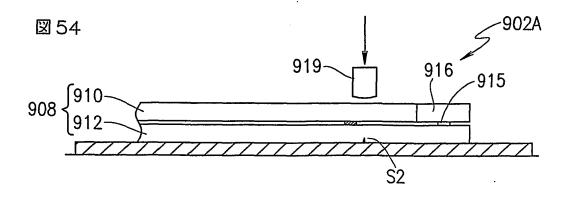


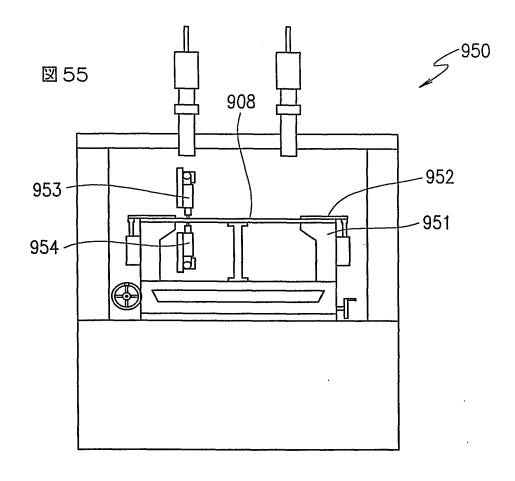












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/00258 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl⁷ C03B33/03, C03B33/023, G09F9/00338, G02F1/1333500, B28D5/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl' C03B33/00-33/14, G09F9/00-9/00338, G02F1/1333-1/1333500, B28D5/00-5/04 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. JP, 9-278473, A (K.K. Berudekkusu), Χ 1,2,4,5,6,8, 28 October, 1997 (28.10.97), 9,14,15,16 Υ Claims; Par. Nos. [0006] to [0007]; Fig. 2 3,7,13 (Family: none) Х JP, 10-209086, A (Matsushita Electric Industrial 1,2,4,16 Co., Ltd.), 07 August, 1998 (07.08.98), Claims; Par. Nos. [0011], [0019]; Figs. 1, 4 (Family: none) JP, 10-338534, A (Toshiba Corp.), Y 3,7 Α 22 December, 1998 (22.12.98), 10-12 Claims; Par. Nos. [0048] to [0055]; Figs. 2, 3 (Family: none) Y EP, 0217658, A1 (Bando Kiko Co., Ltd.), 3 08 April, 1987 (08.04.87), Claims & JP 62-78123 A Claims Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. later document published after the international filing date or Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not priority date and not in conflict with the application but cited to considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention earlier document but published on or after the international filing document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone cited to establish the publication date of another citation or other document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such means combination being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later document member of the same patent family than the priority date claimed

Date of mailing of the international search report

Authorized officer

09 April, 2002 (09.04.02)

Facsimile No. Telephone No.

Japanese Patent Office

Name and mailing address of the ISA/

Date of the actual completion of the international search

28 March, 2002 (28.03.02)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/00258

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,A	JP, 2001-163642, A (Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.), 19 June, 2001 (19.06.01), Claims (Family: none)	1-16
		·

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl⁷ C03B33/03, C03B33/023, G09F9/00 338, G02F1/1333 500, B28D5/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ C 0 3 B 3 3 / 0 0 - 3 3 / 1 4

G09F9/00-9/00 338,

G02F1/1333-1/1333 500, B28D5/00-5/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2002年

日本国登録実用新案公報

1994-2002年

日本国実用新案登録公報 1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
X	JP 9-278473 A (株式会社ベルデックス) 1997.10.28, 特許請求の範	1, 2, 4, 5, 6,		
Y	囲, 第【0006】-【0007】段落, 図 2 (ファミリーなし)	8, 9, 14, 15, 16		
X	JP 10-209086 A (松下電器産業株式会社) 1998.08.07,特許請求の 範囲,第【0011】及び【0019】段落,図1,4(ファミリーなし)	1, 2, 4, 16		
Y A	JP 10-338534 A (株式会社東芝) 1998.12.22, 特許請求の範囲,第 【0048】-【0055】段落,図2,3(ファミリーなし)	3, 7 10-12		
, ,				

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28.03.02

国際調査報告の発送日

09.04.02

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

武重 竜男

4T 9728

電話番号 03-3581-1101 内線 3463

国際調查報告

国際出願番号 PCT/JP02/00258

	国际嗣 宜報古	国际口願番号 PCT/JPO	2/00238		
C (続き).					
引用文献の カテゴリー*	- 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	は、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号		
Y	EP 0217658 A1 (BANDO KIKO CO., LTD) 198 &JP 62-78123 A, 特許請求の範囲		3		
PΑ	JP 2001-163642 A (株式会社豊田自動織機 許請求の範囲 (ファミリーなし)	製作所)2001.06.19,特	1-16		
		•			
	•	•			
1					
		•			
			,		
			; ; ;		
			,		
,					
	•	•			
		,			
,					